

2806120 Ohutkalvotekniikat

Tentti 12.05.2005

KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KÄYTTÖ KIELLETTY

1. Termisen höyrystyksen perusteet. Millaisia höyrystyslähteitä voidaan käyttää ja miten ne toimivat?

2. Millaisiin tarkoituksiin PVD-pinnoitusprosesseissa voidaan hyödyntää kaasun ionisoitumista eli hehkupurkausta (glow discharge)?
3. Magnetron-sputterointi verrattuna perinteiseen (diodi)sputterointiin.
4. Bias-vastajännitteen merkitys pinnoitteen ominaisuuksiin sputteroinnissa.
5. Ohuiden kovapinnoitteiden hyödyntäminen työkaluissa.
6. CVD-prosessien reaktiotyypit. Anna esimerkkejä.